

大電流対応厚銅基板

Heavy Copper PWB

特長 Features

- 大電流ユニットに対応
Correspondence to Large Current unit
- 銅厚: 175 μm ~210 μm
Copper Thickness: 175 μm -210 μm
※内層210 μm (開発中)

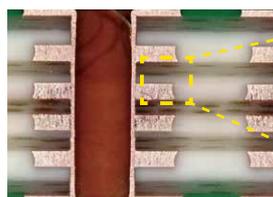
用途 Application

- ジャンクションボックス
- 電源モジュール
- 充電器
- インバーター/コンバーター/トランス

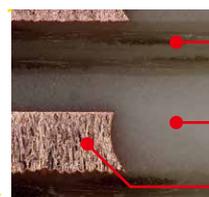
基板仕様 PWB Specification

基板種類	内層導体厚	層構成	板厚	最小導体幅	最小導体間隔	層間厚
厚銅貫通	175 μm	~6層	~3.0mm	400 μm	400 μm	300~350 μm
	210 μm	~6層	~3.0mm	450 μm	450 μm	300~350 μm
基板種類	内層導体厚	層構成	板厚	LVH径	めっき厚	層間厚
厚銅ビルド	105 μm	~6層	~3.0mm	150 μm	60 μm	110 μm

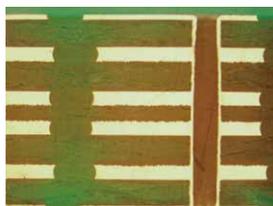
充電設備



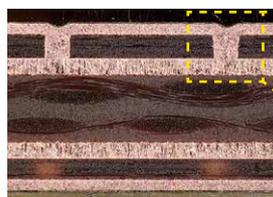
R&D 厚銅貫通基板 内層210 μm



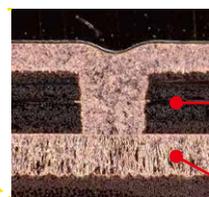
- PP
- 樹脂シート
- 内層導体



量産中 6層貫通 内層175 μm



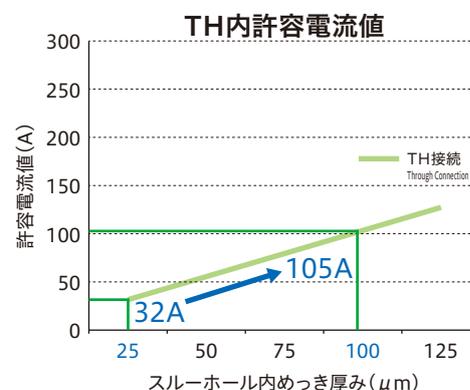
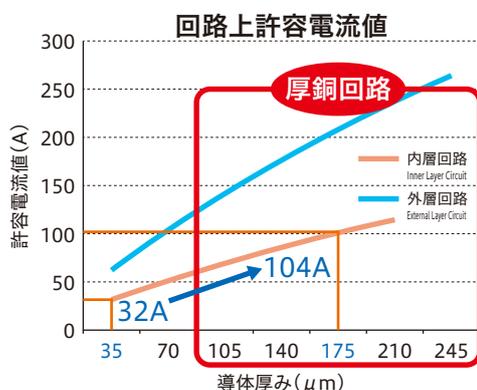
R&D 厚銅ビルド基板 内層105 μm



- 絶縁層: 110 μm
- 内層導体厚 105 μm

許容電流値 Current-Carrying Capacity

一般的な導体厚(35 μm)の許容電流値は32Aとなりますが、導体厚を175 μm にすることで許容電流値を100Aまで向上させる事が可能となります。



上昇温度 ΔT Temperature Rise	10 $^{\circ}\text{C}$
配線幅 Conductor Width	400 μm

上昇温度 ΔT Temperature Rise	10 $^{\circ}\text{C}$
仕上がり穴径 Finished Hole Diameter	$\phi 0.40\text{mm}$
穴数 The Number of Holes	52穴

※基板単体における単独配線を想定したシミュレーション結果であり、お客様での製品時点での結果ではありません。